

超音波フリップチップボンダー

ALPHA
DESIGN

HSB-300U

ALPHA SOLUTION LINE-UP



GGI工法に特化した
世界最高クラスの実装精度を実現した装置です

■ 特長



HSB-300U

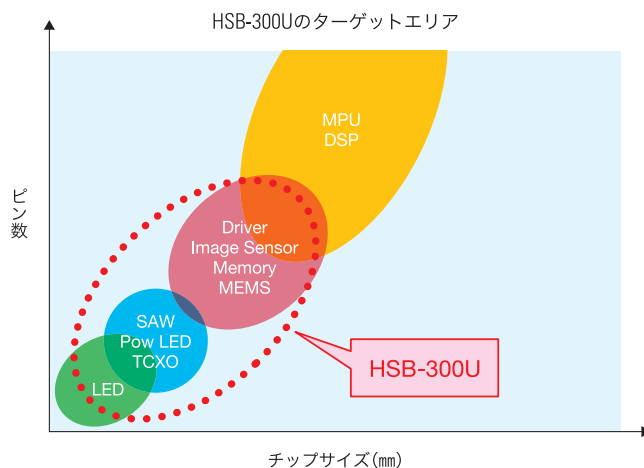
1. 高加圧力で多ピンデバイスに対応
2. 超音波工法に最適な位置と荷重の同時制御
3. 荷重リニア制御可能
4. 加熱加圧ヘッドに段取り替え可能

■ 標準仕様

機種名		超音波フリップチップボンダー
型式		HSB-300U
対象基板サイズ		50×50mm～250×200mm t=0.5mm～2.5mm
対象部品サイズ		□1mm～□12mm t=0.1mm～0.5mm
装置サイズ		幅(W) 1,350×奥行(D) 1,820×高さ(H) 1,550mm (*3色灯除く)
重量		約1,600kg
動力源	電源	3相 AC200V(50/60Hz)
	ドライエア	0.4MPa
	真空源	-80kPa
部品供給形態		ウエハー供給 8インチ、12インチ トレイ供給 2インチ、4インチ
実装精度		±2μm/3σ (X,Y) ※弊社測定方法による。
実装サイクル時間		1.6sec./chip ※プロセス時間は除きます。
加圧レンジ		10N～150N
加熱レンジ		ヘッド : 常温 ステージ: 常温～Max. 150℃
超音波		周波数: 48.5kHz POWER: ～150W ホーンフェイス: 4面
オプション	ディスペンサーユニット	
	ウエハーマップ各種フォーマット対応	
	USヘッド加熱(Max. 200℃)	

※対象部品サイズの詳細はお問い合わせください。

※上記以外の仕様やオプションについてはお問い合わせください。



量産実績

- ・ UPH1500
- ・ bump pitch 75μm(300bump)

※実証実績:bump pitch 45μm(500bump)

お問い合わせは

アルファードesign株式会社

〒389-0511 長野県東御市滋野甲2211-3
TEL 0268-64-0088 FAX 0268-64-0080
<http://www.alpha-design.co.jp/> seihin@alpha-design.co.jp

埼玉支社

〒350-1123 埼玉県川越市協田本町7-6 ダイゴビル5F
TEL 049-293-2795 FAX 049-293-2796

福岡支社

〒819-1122 福岡県糸島市東1963-4 社会システム実証センター 研究開発ラボ205号室
TEL 092-331-8001 FAX 092-331-8041